

第 31 回マイクロエレクトロニクス研究会プログラム

2019年11月9日

会場:TKP 仙台南町通カンファレンスセンター ホール 8B

【基調講演】

- 13:00～13:45 「SiC パワーデバイスが拓くパワエレの新時代; 最新の状況とその将来展望」
ローム(株) 伊野 和英
- 13:45～14:15 「半導体集積回路の配線工程を応用した容量型 MEMS 技術に関する研究」
(株)東芝/東北大学大学院工学研究科 山崎 宏明
- 14:15～14:45 「Ag イオンメモリの高性能化」
キオクシア(株) 山口 まりな
- 15:00～15:30 「半導体実装装置の高精度化・高速化に関する研究」
(株)新川/東北大学大学院工学研究科 瀬山 耕平
- 15:30～16:00 「スマートフォン向け CMOS イメージセンサにおける微細画素開発の意義」
サムスン電子(株) 宮下 直幸
- 16:00～16:30 「全画素像面位相差検出オートフォーカス CMOS イメージセンサの画素開発」
キヤノン(株)/東北大学大学院工学研究科 小林 昌弘
- 16:45～17:15 「原子レベル制御による先進的なエッチング技術」
東京エレクトロン宮城(株) 木原 嘉英

【特別講演】

- 17:15～18:00 「小さな気泡の不思議な世界」
東北大学未来科学技術共同研究センター 高橋 正好

The 31st International Microelectronics Conference Program

Nov.9, 2019

Venue: TKP Sendai Minamimachi-Dori Conference Center, Hall 8B

[Keynote Speech]

- 13:00~13:45 “New Era of Power Electronics with SiC Devices; Latest Status and Future Perspective”
ROHM Co., Ltd.
Kazuhide INO
- 13:45~14:15 “A Study on Capacitive MEMS Device Technologies Using Interconnect Process of Semiconductor Integrated Circuit”
Toshiba Corporation/Graduate School of Engineering, Tohoku University
Hiroaki YAMAZAKI
- 14:15~14:45 “Performance and reliability improvements for Ag Ionic Memory”
Kioxia Corporation
Marina YAMAGUCHI
- 15:00~15:30 “Study on accuracy and speed improvement of semiconductor packaging equipment”
Shinkawa LTD. /Graduate School of Engineering, Tohoku University
Kohei SEYAMA
- 15:30~16:00 “Significance of Development in CMOS Image Sensor with Smaller-dimension Pixels for Smartphone”
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
Naoyuki MIYASHITA
- 16:00~16:30 “Pixel development for all-pixel image plane phase difference detection autofocus CMOS image sensor”
Canon Inc. /Graduate School of Engineering, Tohoku University
Masahiro KOBAYASHI
- 16:45~17:15 “Innovative Future Etch Technology by Atomic-order control”
Tokyo Electron Miyagi Ltd.
Yoshihide KIHARA
- [Special Speech]
- 17:15~18:00 “Fundamental properties and promising applications of tiny bubbles”
New Industry Creation Hatchery Center, Tohoku University
Masayoshi TAKAHASHI